

[参考出展]

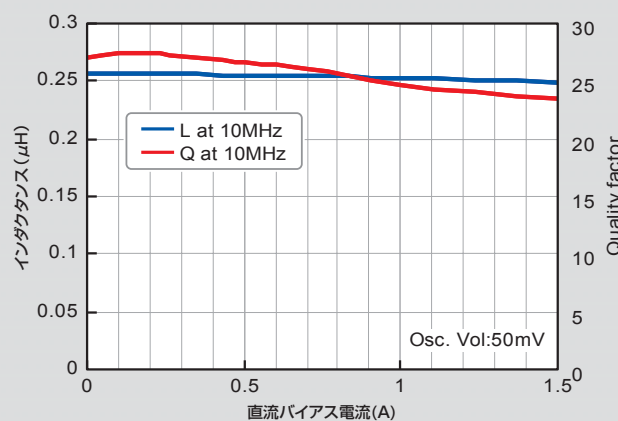
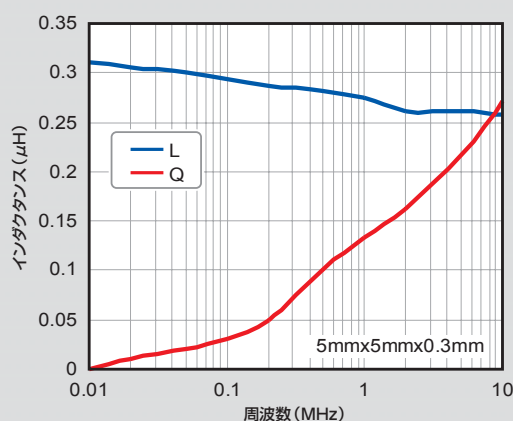
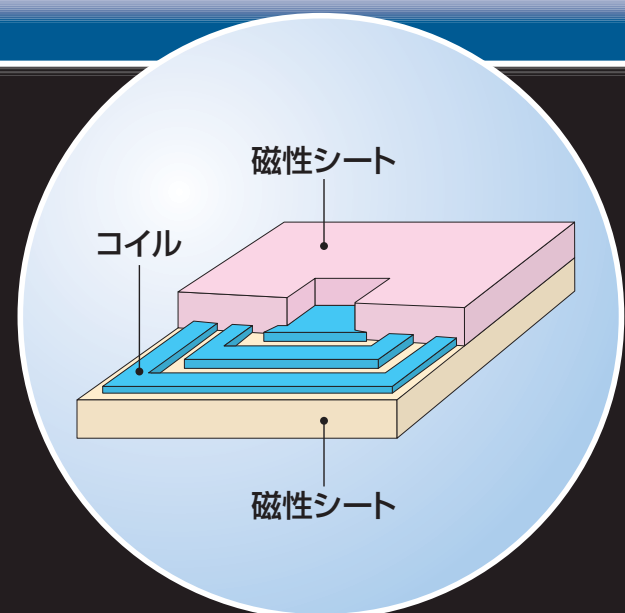
System In Package用 超薄型 (0.3mm) インダクタ

A ultra thin inductor for System in package

超薄型0.3mmのインダクタは、ICペレットと積層してシステム電源ICパッケージに内蔵することが可能です。また、柔軟性を持たせることもできますので、実装隙間に配置するなど従来にはない使い方が可能となります。

特長

- 低背構造
厚さ0.3mm (0.1mm~0.4mmで調整可能)
- 高Q
10MHzの高周波においても高Qを実現 ($Q \geq 25$ 5mm \square)
- 大電流
1A以上の直流重畳電流に対して安定した特性を実現
- フレキシブル性
材料を厳選することにより形状のフレキシブル性を確保



優れたフレキシブル性

主なアプリケーション

- 携帯電話、PHS、PDA、デジタルカメラなどの小型・薄型が要求される携帯機器

用途 (システム電源ICパッケージに内蔵)

- DC-DCコンバータICの出力チョーク
- VRMの出力チョーク

◆従来インダクタとの特性比較

※:測定周波数=2MHz

インダクタタイプ	高さ [mm]	許容電流 [L=20%低下・A]	品質係数 (Q値) @10MHz	インダクタンス [μ H]	直流抵抗 [Ω]
フェライトインダクタ	0.6	0.9	(9)*	0.5	0.05
東芝マテリアル開発品	0.3	≥ 1.5	27	0.25	0.1